



Toshiba entwickelt 4,5kV-Presspack-IEGT mit verbesserter Bruchfestigkeit

*Neues Gehäusedesign bietet eine 1,7-mal höhere Bruchfestigkeit
als herkömmliche Presspack-Gehäuse*

Düsseldorf, Deutschland, 29. Mai 2018 – Toshiba Electronics Europe informiert auf der PCIM 2018 in Nürnberg über das neue Gehäuse für seine 4,5 kV-Presspack-IEGTs (PPIs). Es wurde entwickelt, um die die Bruchfestigkeit der Bausteine zu erhöhen, was im Falle eines Bauteilversagens die Wahrscheinlichkeit von Schäden an benachbarten Bauteilen und Komponenten verringert.

Das Gehäuse basiert auf einem optimalen Volumenverhältnis bei dem weder die Keramik zerstört wird noch Material austritt. Dieses Verhältnis wurde durch Experimente mit dieser Art von Gehäusen ermittelt.

Nach sorgfältigen Messungen hat sich gezeigt, dass das Gehäuse einen Kurzschlussfehler (SCFM; Short-Circuit Failure Mode) über 50 Stunden überstehen kann. Das Experiment wurde mit einem kurzgeschlossenen IEGT-Chip (von 42 IEGT-Chips) bei schlechtmöglicher Platzierung (Randlage) durchgeführt.

Zusätzlich zeigten Tests bezogen auf die Bruchbeständigkeit eine 1,7-mal höhere Festigkeit als bei Standard-PPI-Bauteilen. Diese Tests wurden bei 3200 V durchgeführt.

Diese Forschungsergebnisse werden von Raita Kotani und Georges Tchouangue am Donnerstag, den 7. Juni um 11:15 Uhr auf der PCIM Europe 2018 Conference vorgestellt.

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist die europäische Niederlassung der [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

TEE wurde 1973 in Neuss, Deutschland gegründet, mit heutigem Hauptsitz in Düsseldorf. Von dort aus sowie weiteren Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien werden Design, Fertigung, Marketing sowie Verkauf gesteuert. Präsident des Unternehmens ist Mr. Akira Morinaga. Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html
E-Mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0)193 282 2832
E-Mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek
Tel: +44 (0) 20 8429 6554
Web: www.publitek.com
E-Mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Mai 2018

Ref. 7132/A